

QSFP-DD (双倍密度) 连接器系列和电缆组件

molex

QSFP-DD连接器系列的8通道电气接口可传输高达28 Gbps的NRZ（不归零制）或56 Gbps的PAM-4信号，最大合计速率为200或400 Gbps，该连接器与QSFP连接器具有相同的长宽尺寸，因此兼容以前的设备。

特点和优点

28 Gbps NRZ和56 Gbps PAM4电缆组件

Temp-Flex电缆技术

提高了电气性能。帮助客户提高生产效率，进而实现卓越的运营利润率，缩短交货时间并降低最终用户的成本

32和30 AWG电缆

最长可达5.0米，满足所有行业中各种应用场合的需求。优化成本结构并缩短交货时间

全集成设计

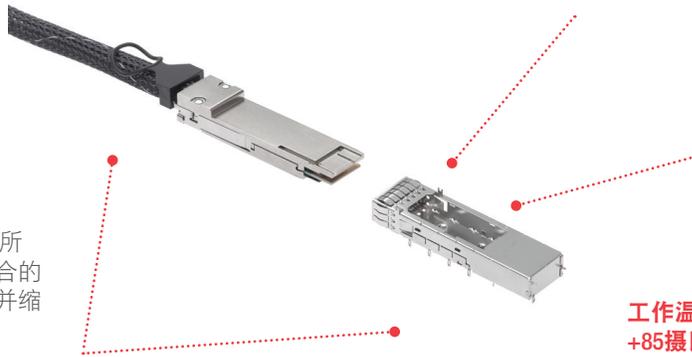
包含Molex的所有元器件（后壳、电缆、装有元器件的电路板）。确保将高质量的元器件整合成具有优异成本结构的综合解决方案

符合IEEE 802.3bj、InfiniBand EDR和SAS 3.0规范
满足多种下一代技术和应用场合的功能要求

双倍密度

加长型双切换卡，
带有两排高速元器件

工作温度为20至
+85摄氏度
可用于高温环境



特点和优点

钣金（不锈钢）EMI（电磁干扰屏蔽）笼罩（系列203143、203152、203369、203370、203371、203372）

不锈钢笼罩结构

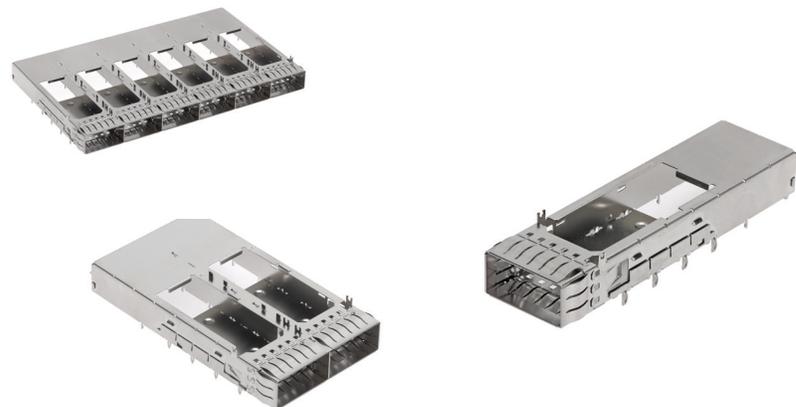
比铜合金材料更坚固

采用与QSFP+连接器相同的对配界面，以便兼容以前的设备

保护最终用户在QSFP+基础设施方面的现有投资

耦合设计采用受欢迎的窄边耦合、经冲裁和成形加工而成的触点几何结构以及嵌件成型，提供卓越的信号完整性（SI），包括极低的插入损耗（IL）

可提供2合1式堆叠式集成连接器和笼罩
支持可插拔的应用场合



镀镍散热片

提高了从模块到散热片的热传递效率

QSFP-DD (双倍密度) 连接器系列和电缆组件

molex

特点和优点

QSFP-DD 表面贴装式 (系列202178) 和堆叠式集成连接器和笼罩 (系列204058)

28 Gbps NRZ和56 Gbps PAM4

符合或超过200千兆比特以太网和InfiniBand 100 千兆比特 (EDR) 应用场合的当前要求。支持过去的10 千兆比特以太网、14千兆比特 (FDR) InfiniBand和16 千兆比特光纤通道应用场合



堆叠式集成连接器包括EMI金属垫圈 (系列171722)

提供卓越的电磁干扰抑制性能



耦合设计采用受欢迎的窄边耦合、经冲裁和成形加工而成的触点几何结构以及嵌件成型

提供卓越的信号完整性 (SI)。在14 GHz以上的频率情况下具有<0.8dB的极低插入损耗 (IL)

0.80毫米端子间距主机连接器。
根据设计，该连接器放置在EMI笼罩下面
支持可插拔的电路

应用场合

电信设备

- 服务器
- 路由器
- 交换机
- 电话局交换机
- 蜂窝基础设施
- 多平台服务系统



服务器

数据网络设备

- 服务器
- 存储器

产品规格

28 Gbps NRZ和56 Gbps PAM4电缆组件

参考信息

包装: EMI袋装

电气参数

频率范围: 10 MHz至25 GHz
中频带宽: 待定
电源电压: 待定
电源电流 (最大值): 待定
功耗 (最大值): 待定

机械参数

可插拔次数:
PL1 - 性能等级1级 -
0.38微米镀金 - 50次, 5年寿命
(无流动混合气体)
PL2 - 性能等级2 -
0.76微米镀金 - 250次, 10年寿命
(14天流动混合气体)

物理参数

后壳 - 锌压铸
拉手 - 尼龙
解锁装置 - 不锈钢
电缆 - 8对, 100欧姆, 差分, CL2
是否符合RoHS标准: 待定
工作温度: 待定
非工作温度: 待定

QSFP-DD (双倍密度) 连接器系列和电缆组件



产品规格

SMT (表面贴装型) 连接器

参考信息

包装: 承载带和卷盘包装
UL文件编号: 待定
CSA文件编号: 待定
对配器件: 铜电缆组件
双倍密度表面贴装型连接器将与201591系列配合使用
设计计量单位: 毫米

电气参数

电压: 30伏
电流 (最大值): 待定
接触电阻 (最大值): 待定
介质耐电压: 待定
绝缘电阻 (最小值): 待定

机械参数

端子对外壳的抓握力: 待定
插配力: 待定
拔脱力: 待定
可插拔次数: 待定

物理参数

外壳: 耐高温热塑性塑料
玻纤填充, UL 94V-0, 黑色
触点: 铜合金
电镀:
接触部位 - 30微英寸 (0.76微米) 镀金
焊尾部位 - 镀锡
底层电镀 - 镀镍
是否符合RoHS标准: 待定
工作温度: 待定

堆叠式集成连接器和笼罩

参考信息

包装: 托盘包装
UL文件编号: 待定
对配器件: 铜电缆组件
(系列201591)
设计计量单位: 毫米

电气参数

电压: 30伏
电流 (最大值): 0.5安; 电源接点: 待定
接触电阻 (最大值): 待定
介质耐电压: 待定
绝缘电阻 (最小值): 待定

物理参数

外壳: 耐高温热塑性塑料
玻纤填充, UL 94V-0, 黑色
接点: 铜合金
电镀:
接触部位 - 30微英寸 (0.76微米) 镀金
信号焊尾部位 - 镀锡/镀铅
底层电镀 - 镀镍
是否符合RoHS标准: 是 - 免检
工作温度: 待定

机械参数

对配力: 每路0.75牛
拔脱力: 每路0.25牛
可插拔次数: 30微英寸镀金: 100次

EMI钣金笼罩

参考信息

包装: 托盘包装和盒装
对配器件: QSFP+电缆组件 (系列74757、111040) QSFP+环回适配器 (系列74763)
zQSFP+电缆 (系列111114) QSFP+双密度电缆组件 (系列201591)
配套器件: 连接器 (系列202718)
设计计量单位: 毫米

机械参数

可插拔次数:
1次插入电路板
1合1对配力 (最大值): 待定
1合1拔脱力 (最大值): 待定
6合1对配力 (最大值): 待定
6合1拔出力 (最大值): 待定

物理参数

电镀: 镀镍
钣金: 不锈钢
散热片: 铝
散热片表面处理: 镀镍
工作温度: 待定

订购信息

系列号	零部件	端口配置	排数	引脚数
203143	EMI笼罩	1合1	单排	5个功率引脚
203152		2合1		
203369		3合1		
203370		4合1		
203371		5合1		
203372		6合1		

系列号	零部件
204058	堆叠式笼罩
202718	表面贴装型连接器

www.molex.com/link/qsfpdd.html
www.chinese.molex.com/link/qsfpdd.html

MOLEX 是 MOLEX, LLC 在美国的注册商标, 并且可能在其他管辖权下注册; 此处列出的所有其他商标皆属于其相应的所有者。